

LPKF NEWSLETTER

+++ Mit dem 9-Monatsbericht 2000 +++

LPKF Laser & Electronics AG (WKN 645000) · Osteriede 7 · D-30827 Garbsen · Telefon +49(0) 51 31-7095-0

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,



es herrschen unruhige Zeiten an den Finanzmärkten. Und das ist natürlich auch an LPKF nicht spurlos vorübergegangen. Wir sehen trotzdem mit Genugtuung, dass fast alle größeren LPKF-Investoren

weiterhin Vertrauen bewiesen oder ihr Engagement sogar noch ausgeweitet haben.

Wir sind mit unseren Partnern in ständigem persönlichen Kontakt und sie wissen, welches Potenzial in unserem Unternehmen steckt. Mit dem MicrolineLaser, ProtoLaser, Polymer StencilLaser und dem Inspektionssystem ScanCheck haben wir in diesem Jahr bereits vier völlig neue Systeme in den Markt eingeführt und die ersten Verkäufe abgeschlossen. Möglicherweise noch im vierten Quartal dieses Jahres werden 3D-Laser und MicrolineDrill, ein Laserbohrsystem für Leiterplatten, folgen.

Natürlich gibt es bei einer derartig hohen Innovationstätigkeit auch das Risiko der Marktakzeptanz – es ist nicht exakt vorhersehbar, wann und in welcher Form der Markt neue Prozesse einführt. Auf der Haben-Seite steht ein enormes Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre, verteilt auf immer mehr innovative Produkte für die Elektronikfertigung.

Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung.

Herzliche Grüße

Bernd Hildebrandt
(Vorstandsvorsitzender)

Vorstoß ins Reich der Mitte: LPKF gründet neue Firma in China

„Es geht darum, den am schnellsten wachsenden Markt von Elektronikprodukten bedienen zu können.“ So kommentiert Produktions- und Vertriebsvorstand der LPKF Laser & Electronics AG, Bernd Hackmann, die in diesem Herbst erfolgte neuste Firmen-gründung. LPKF Tianjin Co. Ltd., so der Name der Neugründung, wurde für den Vertrieb von StencilLasern und Rapid-Prototyping-Systemen gegründet. Damit schafft LPKF jetzt auch in Fernost eine organisatorische Struktur, wie sie sich in den USA, den Beneluxstaaten und zuletzt in Frankreich durch die Gründung von LPKF France bereits bewährt hat.



LPKF Tianjin mit Sitz südöstlich von Peking ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Konzerns. Neben dem Vertrieb wird dort auch die Musterproduktion von Prototyp-leiterplatten und Stencilschablonen eingerichtet. Eine Reihe von Serviceleistungen wie etwa die Wartung und Reparatur von StencilLasern gehört ebenfalls zum Programm.

Geographisch betritt LPKF mit diesem Engagement keineswegs Neuland. Vielmehr handelt es sich um ein weiteres Kapitel in einer Erfolgsstory, die bereits 1985 begann. Mit den bewährten Rapid-Prototyping-Systemen ging man bereits vor 15 Jahren erstmalig auf den chinesischen Markt – und hatte damit von Anfang an Erfolg. Viele Rapid-Prototyping-Systeme wurden seither ins „Reich der Mitte“ verkauft. Vor einigen Jahren startete dann auch der Vertrieb von StencilLasern. „Die enor-

men Wachstumchancen, die gerade der chinesische Markt eröffnet“, so Bernd Hackmann, der für LPKF Tianjin als Chairman fungiert, „haben jetzt ein geordnetes Marketing sowie einen Ausbau des Servicebereiches notwendig gemacht.“ Als General Director für LPKF Tianjin



General Manager Jürgen Hua,
General Director Mathias Hu (rechts)

konnte Mathias Hu gewonnen werden. Der 44-jährige Ingenieur Hu arbeitet bereits seit mehr als zehn Jahren mit LPKF zusammen. Er besitzt praktische Erfahrung sowohl im Bereich der Leiterplattenproduktionstechnologie, als auch der Steuerungssoftware. Er vertreibt seit Jahren erfolgreich LPKF-Produkte in China. Unterstützt wird Hu von Jürgen Hua in der Funktion des General Managers. Hua, Maschinenbau- und Konstruktionsingenieur, mit Weiterbildung im Bereich Betriebswirtschaft, besitzt ebenfalls umfassende Erfahrung im Vertrieb von LPKF-Produkten. Im Hause LPKF verspricht man sich viel von der chinesischen Neugründung: „Wir sind froh, dass wir in diesem rasch wachsenden Markt bereits auf langjährige Kontakte mit der Führungsscrew zurückgreifen können, die über ein profundes Marktwissen in China verfügt“, sagt Bernd Hackmann.

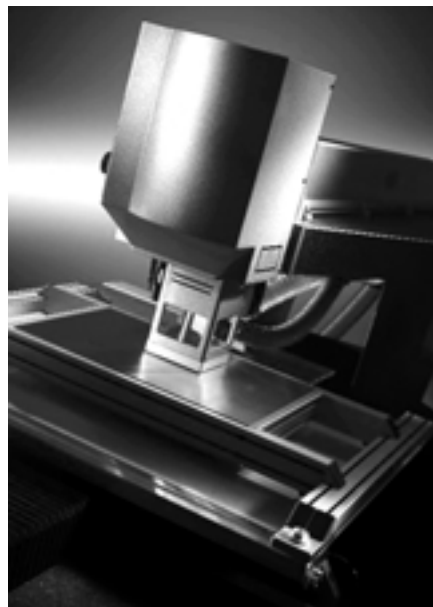
LPKF stellt neue Leiterplattenbohrmaschine vor

Das Modell MicrolineDrill zum Bohren und Strukturieren von Feinstleiterschaltungen

Mit einer neuartigen Leiterplattenbohrmaschine liefert LPKF wieder einmal ein Beispiel für eine besonders kundennahe Entwicklung. Das Modell „MicrolineDrill“ ist in technischer Hinsicht ein echtes Novum: Erstmals können mehrlagige Leiterplatten mit einer einzigen Maschine nicht nur mittels Laser gebohrt, sondern auch strukturiert werden. Das Bohren mittels Laser dient zum Verbinden der verschiedenen Ebenen von Mehrlagenschaltungen. Die Bohrdurchmesser im μm -Bereich entsprechen dem halben Durchmesser eines menschlichen Haares. Damit sind die Leiterplattenhersteller für die Marktanforderungen der Zukunft gerüstet. Als Besonderheit können mit dem gleichen Gerät die Leiterbahnen auch strukturiert werden. Hierbei sind Breiten von 30 μm möglich.

Bisher waren für diese beiden Arbeitsgänge stets zwei verschiedene Anlagen notwendig. Daher auch die entsprechend hohen Anschaffungskosten. Mit MicrolineDrill hat LPKF auf ausdrücklichen Kundenwunsch jetzt eine Anlage entwickelt, die gerade auch für kleinere Hersteller geeignet ist, die bisher den finanziellen Aufwand gescheut haben. Einsatzgebiete des neuen LPKF Microline-Drills sind hochintegrierte Schaltungen, wie sie etwa bei Mobiltelefonen oder in der digitalen Fotografie verwendet werden. Der potenzielle Kundenkreis umfaßt alle Leiterplattenhersteller, die sich auf Feinstleiterschaltungen spezialisiert haben.

Mit dem MicrolineDrill peilt LPKF einen Markt an, der ein enormes Wachstumspotenzial besitzt. Rund 400 Laserbohrmaschinen sind derzeit weltweit im Einsatz. In den nächsten Jahren rechnen Experten mit einer Verhundertfachung der Zahl der Installationen. Mit einem Produkt, das durch seine raffinierte Doppelfunktion nicht nur technisch überzeugt, sondern auch preislich vielen Anwendern eine günstigere Alternative bietet, hat LPKF die besten Erfolgchancen in diesem wichtigen Marktsegment.



Neubau fertiggestellt

Kennzeichen für das Wachstum des Unternehmens

Nach nur einjähriger Bauzeit konnte in diesem Herbst das neue Firmengebäude in Garbsen bezogen werden. Mit einem Zugewinn von 2.200 Quadratmetern verdoppelte sich damit nahezu die Nutzfläche in der Firmenzentrale. Dringend benötigt wurde der zusätzliche Platz – dank der ausgezeichneten Geschäftslage – unter anderem für den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie für die Aufstockung des Personals (siehe *Personalien*). Mit umgezogen ist ebenfalls die Vertriebs- und Serviceabteilung. Der Vorstand residiert seit Oktober im obersten Stockwerk des dreistöckigen Gebäudes. Vorstandsmitglied Bernd Hackmann: „Damit haben sich die Wege innerhalb des Betriebes erheblich

verkürzt.“ Geplant war der Ausbau schon seit mehreren Jahren. Bereits 1997 hatte man zu diesem Zweck ein angrenzendes Grundstück erworben. Im Herbst vergangenen Jahres begannen dann die Bauarbeiten und konnten dank günstiger Witterungsbedingungen schon nach gut zwölf Monaten abgeschlossen werden. In der Optik ähnelt der dritte Bauabschnitt dem Kerngebäude von 1991 und dem Anbau von 1996. Neben den funktionellen Aufgaben erfüllt das neue Firmengebäude mit seiner großzügigen Anlage auch die repräsentativen Ansprüche eines weltweit operierenden Konzerns und leistet damit einen bedeutsamen Beitrag zur Unternehmenskultur von LPKF.

+ Meldungen +

Personalien



Bernd Lange, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, ist bei der LPKF seit August als Vertriebsingenieur im Bereich Lasersysteme angestellt. Zu seinen Aufgaben gehört u.a. die Kundenakquisition und die Unterstützung der Auslands-

vertretungen. Bernd Lange besitzt langjährige Erfahrung im Bereich Laser; in seiner vorherigen Tätigkeit war er Vertriebsleiter für dieses Gebiet in einem mittelständischen Unternehmen.

Personalaufstockungen gab es ferner in den Abteilungen Auftragsabwicklung, Einkauf und im Marketing, das ab sofort für die gesamte internationale Präsenz des Unternehmens verantwortlich ist.

Messetermine



Auf der diesjährigen **electronica2000**, vom 21. bis 24. November in München, ist LPKF wieder mit einem eigenen 84,5 m² großen Stand vertreten. Präsentiert werden u.a. verschiedene Maschinen der Fräsbohrplotterserie sowie zahlreiche Dokumentationen auch aus dem Laserbereich. Die **electronica2000** ist die bedeutendste Fachmesse für Bauelemente der Elektronikbranche. Für LPKF ist sie eine der wichtigsten Messen überhaupt.

Weitere wichtige Messetermine im nächsten Quartal:

14.-17.11.2000
Nepcon/Microelectronics

25.-27.11.2000
Philtronics, Philippinen

29.11.-02.12.2000
EuroMold, Deutschland

06.-08.12.2000
Semicon Japan

16.-18.01.2001
APEX 2001, USA

14.-16.02.2001
Embedded Systems, Deutschland

20.-22.02.2001
Wireless Symposium Portable by Design, USA

27.-29.03.2001
Micro System Technologies, Deutschland

Kooperation mit Enthone

Weiteres Einsatzgebiet für die LPKF Microline-Lasertechnologie eröffnet

Um die Schaffung einer wegweisenden Technologie für die Leiterplattenherstellung geht es bei dem aktuellen Kooperationsprojekt zwischen LPKF Laser & Electronics AG und der Enthone-OMI GmbH Solingen, einem der führenden Chemielieferanten und Basismaterial-Zulieferer für die Leiterplattenindustrie. Ziel der Zusammenarbeit, für die jetzt ein Kooperationsvertrag geschlossen wurde, ist die Entwicklung eines neuartigen lasergestützten Verfahrens zur Erzeugung feinsten

Leiterbahnen. Im Unterschied zu herkömmlichen Verfahren für die Serienfertigung von Leiterplatten kommt die geplante Technologie ohne umweltschädliche Ätztechnik aus, die bei der industriellen Produktion von Schaltungsträgern bisher unverzichtbar war. „Der Nutzen für den Anwender“, so LPKF-Forschungsvorstand Dr. Jörg Kickelhain, „liegt vor allem in der großen Schnelligkeit des Verfahrens.“ In dem gemeinsamen Technologieprojekt ist Enthone zuständig für die

Entwicklung einer speziellen Beschichtung, die sich mittels Laser bearbeiten lässt. LPKF steuert die Lasertechnik und Enthone das Metallisierungsverfahren bei. „Die Ergebnisse der Kooperation werden einen wichtigen Beitrag zur weiteren Miniaturisierung elektronischer Baugruppen leisten“, meint Dr. Kickelhain. Für LPKF erweitert sich damit auch das Anwendungsspektrum der bewährten MicrolineLaser-Technologie.

9-Monatsbericht 2000

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

auch nach neun Monaten verzeichnet die LPKF Laser & Electronics AG eine deutliche positive Entwicklung. Der Umsatz wuchs um 29,6 % im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres. Mit einem Konzernergebnis von TDM 4.704 ist jetzt schon das Resultat des gesamten Jahres 1999 (TDM 4.408) übertroffen worden.

1. Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss auf den 30. September 2000 der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, wurde nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. Dabei fanden die am Bilanzstichtag geltenden Standards des International Accounting Standards Committee (IASC) Anwendung.

2. Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, sind folgende Tochterunternehmen in den Konzernabschluss einbezogen worden:

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Erwerb
Vollkonsolidierung			
ELASER GmbH	Suhl / Thüringen	100,0	1989
LPKF d.o.o.	Kranj / Slowenien	75,0	1995
Franklin Industries N.V.	Mechelen/Belgien	100,0	1995
LPKF Laser & Electronics Inc.	Portland / USA	60,0	1999
A-Laser Inc.	Beaverton / USA	100,0	1999
LPKF Motion & Control GmbH	Suhl / Thüringen	50,9	1999
LPKF Properties, LLC	Wilsonville / USA	60,0	1999
LPKF France S.A.R.L.	Lisses / Frankreich	94,0	1999
LPKF Laser Components GmbH	Garbsen	80,0	1999

3. Gewinn pro Aktie

Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2000 beläuft sich der unverwässerte Gewinn pro Aktie bei einem Konzernergebnis von TDM 4.704 und ausgegebenen Aktien von 10.500.000 Stück auf DM 0,45 (DM 0,30)¹⁾. Der verwässerte Gewinn liegt bei DM 0,43 (DM 0,29)¹⁾.

¹⁾Vorjahreswert

4. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl setzt sich zum 30. September 2000 wie folgt zusammen:

	30.09.00	30.09.99
Produktion	55	29
Vertrieb	30	23
Forschung & Entwicklung	34	20
Technik und Verwaltung	59	43
	178	115

5. Segmentberichterstattung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

a) Produktgruppen

	01.01. – 30.09.00	01.01. – 30.09.99
	TDM	TDM
Lasersysteme ²⁾	16.476	14.707
Rapid Prototyping	16.869	11.161
Schablonen	2.751	1.220
Sonstiges	849	1.412
	36.945	28.500

²⁾incl. neuer Technologien

b) Regionen

	01.01. – 30.09.00	01.01. – 30.09.99
	TDM	TDM
Deutschland	7.521	6.071
Übriges Europa	4.626	6.618
Nord-Amerika	13.249	8.389
Süd-Amerika	53	254
Asien	10.853	6.498
Übrige	643	670
	36.945	28.500

Konsolidierte Bilanz (TDM)

Aktiva	30.09.2000	31.12.1999	Passiva	30.09.2000	31.12.1999
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.667	5.749	Gezeichnetes Kapital	20.536	10.500
Sachanlagen	16.149	13.031	Kapitalrücklage	7.085	17.121
Finanzanlagen	36	43	Gewinnvortrag	7.610	4.252
	21.852	18.823	Konzernergebnis	4.704	4.408
Umlaufvermögen			Ausgleichsposten aus der		
Vorräte	18.110	13.071	Währungsumrechnung	777	334
Forderungen aus Lieferungen			Ausgleichsposten für Anteile		
und Leistungen	10.058	6.076	anderer Gesellschafter	2.696	2.163
Sonstige Vermögensgegenstände	2.041	1.665		43.408	38.778
Wertpapiere	117	117	Rückstellungen		
Kassenbestand,			Rückstellungen für Pensionen	417	439
Guthaben bei Kreditinstituten	8.464	12.875	Steuerrückstellungen	2.828	1.589
	38.790	33.804	Sonstige Rückstellungen	983	1.330
Rechnungsabgrenzungsposten	78	67		4.228	3.358
Aktiver Steuerabgrenzungsbetrag	768	375	Verbindlichkeiten		
Total Aktiva	61.488	53.069	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.124	3.310
			Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	360	0
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
			und Leistungen	2.165	2.094
			Sonstige Verbindlichkeiten	2.790	4.249
				11.439	9.653
			Rechnungsabgrenzungsposten	155	62
			Abgrenzungsposten Zuwendungen	1.221	274
			Passiver Steuerabgrenzungsbetrag	1.037	944
			Total Passiva	61.488	53.069

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (TDM)

	01.01. – 30.09.00	01.01. – 30.09.99
Umsatzerlöse	36.945	28.500
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.031	843
Andere aktivierte Eigenleistungen	955	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.258	2.194
	40.189	31.537
Materialaufwand	9.555	7.079
Personalaufwand	10.740	7.456
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.040	1.757
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.810	8.694
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	161
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	282	326
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384	230
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.942	6.808
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.915	3.416
Konzernjahresüberschuss	5.027	3.392
Ausgleichsposten für andere Gesellschafter	-323	-237
Konzernergebnis	4.704	3.155

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Oktober wurde in China die 100 %ige Tochtergesellschaft LPKF Tianjin Co. Ltd. gegründet.

Konsolidierte Mittelflussrechnung (TDM)

	01.01. – 30.09.00	01.01. – 30.09.99
Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss	5.027	3.392
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.040	1.757
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	64	-48
Veränderungen der Vorräte, Forderungen und sonstige Aktiva	-9.794	-5.736
Veränderungen des sonstigen Fremdkapitals	1.140	3.780
Mittelab-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-523	3.145
Investitionstätigkeit		
Anlageinvestitionen	-6.068	-2.691
Erlöse aus Anlageabgängen	0	78
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-6.068	-2.613
Finanzierungstätigkeit		
Zahlung Dividende	-1.050	0
Anteile anderer Gesellschafter	210	490
Sonstige Ausleihungen	-7	0
Veränderung langfristiger Bankdarlehen	3.508	-4.126
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.661	-3.636
Veränderung des Finanzmittelbestandes		
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbedarfs	-64	-57
Veränderungen des Finanzmittelbedarfs	-3.930	-3.104
Finanzmittelbestand am 01.01.	12.122	16.788
Finanzmittelbestand am 30.09.	8.128	13.627
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes		
Liquide Mittel	8.464	13.993
Kontokorrentverbindlichkeiten	-336	-366
Finanzmittelbestand	8.128	13.627

Impressum

Herausgeber: LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, Internet: www.lpkf.de · Auflage: 1200 Deutsch / 450 Englisch
 Stand: 06.11.2000 · Konzeption, Koordination und Redaktion: Peter Kirch Communications, Hannover
 Tel: +49 (0)5 11-8 56 54-0 · Gestaltung: Ahlers Heinel Werbeagentur, Hannover